



【AEC-Q100 Grade0対応】画像相関法(DIC)を用いた微小領域の熱変形挙動評価

冷却・加熱中のサンプル表面に生じた変位量を画像相関法により定量化いたします。

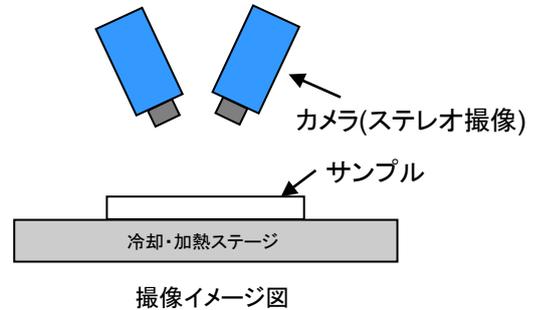
技術の特徴

- 加熱時の熱揺らぎの抑制により
 - (1)冷却・加熱中のサンプル表面の変形挙動を高精度*で評価できます。
 - (2)冷却～昇温中の連続的な変形挙動を解析できます。

装置仕様

冷却・加熱方法:伝熱式
 冷却・加熱ステージの大きさ:250×150mm
 *測定温度、測定サンプルサイズはご相談ください。

- AEC-Q100のGrade 0 (-40°C to +150°C)の温度域にも対応できます。
 (AEC: Automotive Electronics Council)



集積回路の冷却・加熱中の面外変形挙動解析の事例

- 冷却・加熱中のサンプルの仮想線(又は点)上の変形挙動を解析可能です。
 *本解析事例の不確かさは0.6μm以下(サンプルサイズ・イメージスケールによって変わります。)
- 集積回路の50°C加熱時の変形挙動を解析しています。DIC解析の結果、集積回路の最大主ひずみが分かります。

